



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 半导体封装翘曲管理的最新进展

演讲人: 樊学军 教授 美国拉马尔大学

演讲摘要:

半导体封装行业面临的一个关键挑战是封装翘曲，这会影晌集成电路的整体质量和功能。最近，由于各种异构集成解决方案的出现，包括封装上封装（PoP）技术、扇出晶圆级封装（FO-WLP）和嵌入式技术，翘曲问题变得更具挑战性。本次网络研讨会深入探讨了半导体封装翘曲管理的复杂性，提供了对原因和缓解翘曲的高级策略的见解，例如创新材料选择、先进的制造工艺、仿真和建模在预测和解决翘曲方面的作用，以及测量工具。此外，该网络研讨会还将讨论封装翘曲对器件可靠性、热管理和整体系统性能的影响。

演讲人简介:

樊学军是德克萨斯州立大学系的董事教授，也是得克萨斯州博蒙特拉马尔大学的 Mary Ann 和 Lawrence E. Faust 的特聘教授。樊博士是 IEEE 院士，也是 IEEE 杰出讲师。他获得了 2017 年杰出持续技术贡献奖。2011 年获得 IEEE 电子封装协会颁发的杰出技术成就奖。樊博士是异构集成路线图建模与仿真委员会的联合主席。2004 年至 2007 年，樊博士在亚利桑那州钱德勒市的 Q&R 部门担任英特尔高级工程师。